

板バネ式 PGAパッケージ・ソケット

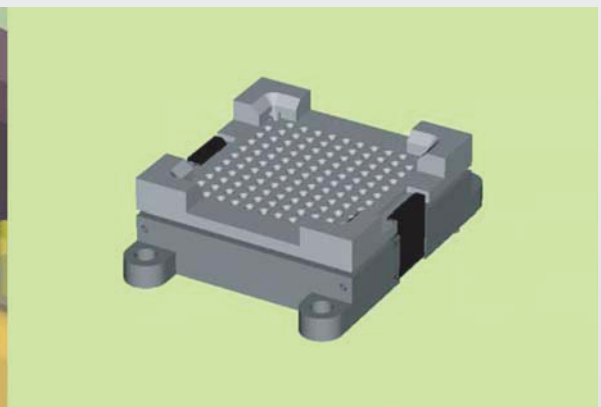
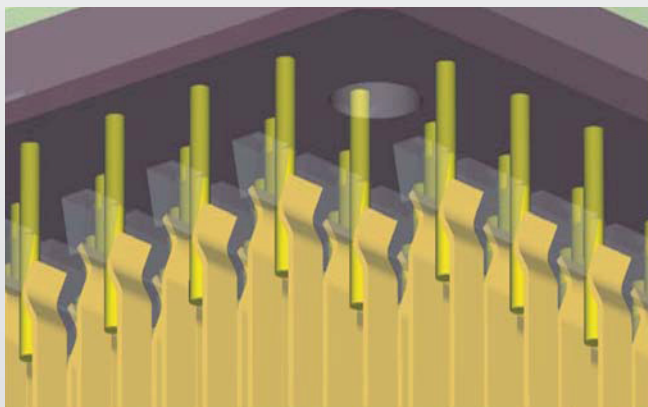
PGA LIF Contact socket

特 長 【 Features 】

- ◆ 各種PGAパッケージに対応。
Available for any PGA packages
- ◆ 挿入・抜去の操作力が低い。
Lower insertion and withdrawal force
- ◆ コントクトの交換が可能。
Lesser damage to soldering ball.
- ◆ 長寿命・高信頼性コンタクト。
Super long life and high reliability contact.
- ◆ 低価格(標準コンタクト採用)
Low cost (Introduced Standard contact)
- ◆ 自動化対応が可能
Applicable to automated system
- ◆ ケルビン対応が可能
Applicable to Kelvin



板バネコンタクト・コンタクトイメージ図
Spring plate, Contact Image View



◆ コンタクト 【Contact】

型 名 (Part)	CM134-0151M3
母材質 (Base Material)	ベリリウム銅(BeCu) Beryllium Copper
厚さ (Thickness)	150 μ m
メッキ (Plated)	Au合金メッキ(1~2 μ m) Gold Plated

◆ コンタクト標準特性 【Contact Data】

型 名 (Part)	CM134-0151M3
荷重[N] (force)	0.10
接触抵抗[m Ω](C-R)	20typ
通電電流[A]	1.0

・通電電流: 通電能力は条件にて大きく異なります。詳細は個別にお問い合わせください。

Conduction Current: Power distribution varies depending on conditions.
Please inquire for details.

- ◆ お客様の仕様にあわせて検討いたします。お問い合わせください。

For any requests of your specifications, please feel free to contact us.

